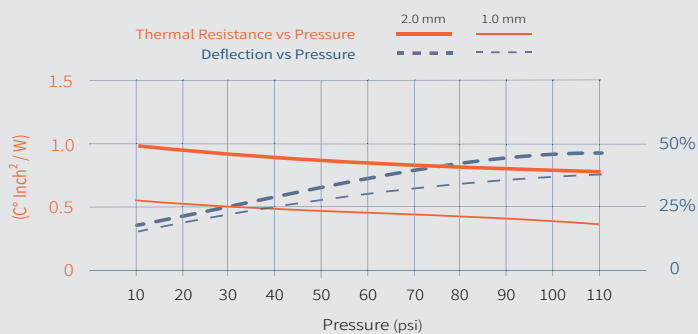


Thermal Interface Material Silicone Gap Filler



Verstärkung
Reinforced layer
V = mit / with

Materialstärke
Material thickness
1.00 = 1.00 mm

DS-GAP-LS30-2.5-**X.XX**-**X**

DS-GAP-LS30-2.5

Wärmeleitfähigkeit ¹ Thermal Conductivity ¹	W/mK	2.50
Härte ² Hardness ²	Shore 00	30
Einsatztemperatur ³ Operation Temperature ³	°C	-40 / +180
Materialstärke Material Thickness	mm	0.30 - 5.00
Durchschlagsfestigkeit ⁴ Dielectric Strength ⁴	kV/mm	6.00
Verstärkung Reinforced Layer	√	optional
Konformität Conformity	√	RoHS
Dichte Density	g/cm ³	2.50

1 Hot Disk 2 ASTM D2240 3 EN344 4 ASTM D149

REV2017_01

Technische Änderungen vorbehalten, alle technischen Daten und Angaben unverbindlich.
Subject to technical alterations, all technical data and details are not binding.